

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-037

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、博普资产、创金合信、混沌投资、前海再保险、安信基金、泰达宏利、国源信达、摩根士丹利、国信自营、富荣基金、鹏华基金、橡果资管、方正证券、恒越基金、易方达、前海人寿、远望角投资、开源资管、中盈蓝景、西部证券、华夏基金、东吴证券、万家基金、盘京投资、国寿资产、弘毅远方、中信保诚基金、中邮基金、国寿资产、天弘基金、泰康基金、大家资产、交银施罗德、平安基金、中海基金、国寿资产
时间	2025 年 12 月 23 日（周二）10:00-11:00 2025 年 12 月 23 日（周二）16:00-17:30 2025 年 12 月 26 日（周五）10:00-11:30 2025 年 12 月 26 日（周五）14:00-15:30
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、如何看待存储涨价的持续性？</p> <p>答：结合第三方机构信息来看，AI 技术应用持续推升云服务商对高效能 TLC eSSD、QLC eSSD 的需求，叠加 HDD 供应短缺促使云服务商转单至 SSD，NAND Flash 需求迎来爆发；受过往周期影响，主要原厂维持审慎的产能扩张策略，若后续资本开支回升，受制于产能建设周期的滞后性，对 2026 年位元产出的增量贡献也将较为有限。</p> <p>2、如何看待公司存货规模的变化趋势？</p> <p>答：公司的备货策略以需求预测为基础，并结合市场走势、存储晶圆价格、库存情况、客户订单情况等综合分析，适时进行备货采购。公司通过与存储晶圆原厂签署长期供货协议（LTA）或商业合作备忘录（MOU），能有效确保持续稳定供应。</p> <p>3、公司新产品 mSSD 相较于传统 SSD 有哪些优势？mSSD 未来会有多大的市场空间？</p> <p>答：公司 mSSD 采用 Wafer 级系统级封装（SiP），将主控、NAND、PMIC 等元件整合进单一封装体内，实现了从 Wafer 到产品化的一次性封装，省去了 PCB 贴片、回流焊等多道 SMT 环节，产品具备明显的综合成本优势。</p> <p>公司 mSSD 提供 TB 级别的多档容量，通过集成封装大幅压缩了产品体积，实现轻薄化、紧凑化，并通过深度技术优化，使其性能仍能满足 PCIe 接口的高标准。</p> <p>公司 mSSD 创新性地配备卡扣式散热拓展卡，无需工具即可灵活拓展为目前 SSD 的主流规格，在综合适配性与使用效益上，更能匹配当下多样化的存储应用需求。</p> <p>4、如何看待未来公司中长期的盈利能力变化趋势？</p> <p>答：近年来公司在高端存储、海外业务以及自研主控芯片等方面持续取得突破，内生性成长因素将更直接且持续地驱动公司盈利能力的提升。</p>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5、公司主控芯片未来的研发方向？</p> <p>答：公司将围绕 UFS、eMMC、SD 卡、PCIe SSD 等领域，进行芯片架构设计、固件算法开发、中后端设计等，以无晶圆厂（Fabless）模式推出系列高性能主控芯片，提升公司存储产品的竞争力。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无